附件1

集成电路产业财政奖补政策项目申报表

申请主体（盖章） 申请日期： 年 月 日

| **项目申请主体填写** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请主体**  **基本情况** | 申请主体名称 |  | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | |
| 联 系 人 |  | 电话 |  | | 手机 | |  |
| **项目基本情况（流片费用补贴项目填写）** | 项目名称 |  | | | | | | |
| 项目类型 | 多项目晶圆流片□ 全掩膜流片□ | | | | | | |
| 产品工艺 | 工艺制程 纳米□ 以碳化硅晶片作为衬底□  特色工艺□ | | | | | | |
| 流片费用 |  | | | 申请补助金额 | |  | |
| **项目基本情况（封装测试公共服务平台项目填写）** | 项目名称 |  | | | | | | |
| 服务企业数量 |  | | | | | | |
| 服务收入（万元） |  | | | | | | |
| 申请补助（万元） |  | | | | | | |
| **审批部门填写** | | | | | | | | |
| **市级部门初审意见** | （盖章）：  年 月 日 | | | | | | | |
| **省级部门审核意见** | （盖章）：  年 月 日 | | | | | | | |

附件2

信用承诺书

我单位郑重承诺，提交的全部资料真实有效、完整准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我单位同意将以上承诺事项纳入信用档案，并作为事中事后监管的参考。如违反以上承诺，自愿退还全部补助资金，终止享受有关扶持政策，并依法依规接受约束和惩戒。

申报单位（公章）

年 月 日

附件3

流片费用补贴申报明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **申报类型**  **（MPW或全掩膜）** | **代工**  **企业** | **申报金额**  **（万元）** | **合同签订时间** | **数量**  **（片）** | **合同金额**  **（万元）** | **记账凭证号** | **发票号** | **发票时间** | **发票金额（万元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额（万元）** | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**注：① 此表的电子资料请提供Excel版。**

**② 相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、银行回单1、发票1、合同2、记账凭证2、银行回单2、发票2……”的顺序依次装订。**

附件4

集成电路封装测试平台奖补申报信息明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同名称** | **合同签订时间** | **合同金额**  **（万元）** | **记账凭证号** | **发票号** | **发票时间** | **发票金额（万元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额（万元）** | | |  |  |  |  |  |

**注：① 此表的电子资料请提供Excel版。**

**② 相关证明材料需以“合同名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、发票1、合同2、记账凭证2、发票2……”的顺序依次装订。**

附件5

集成电路产业财政奖补政策项目汇总表

填报单位：XX市 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主体名称 | 项目名称 | 流片费用  （万元） | 服务企业或机构数量（个） | 服务收入  （万元） | 申请补助金额  （万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| （一）流片项目小计 |  |  |  |  |  |
| XX企业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （二）封装测试公共服务平台项目小计 |  |  |  |  |  |
| XX企业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |